

преобразованию внутренней энергии НС во внутреннюю энергию производимой детали. Для того чтобы этим воспользоваться необходимо ввести определённые ограничения. Эти ограничения должны обеспечить воспроизводимость условий получения данной погрешности. Это материал заготовки, её габариты, это инструмент и т.д., т.е. условие возмущения, а реакция в виде объёма оставшегося материала. В этом случае безразмерная величина χ является показателем качества НС станка как отношение реакции к возмущению.

$$\chi = \frac{\int_0^Z q(Z) dZ}{S \times \tau \times t}$$

Для апробации сформулированных положений был поставлен эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы получить количественные значения показателя χ . В эксперименте участвовали 7 станков токарного типа. Для того чтобы учсть влияние термических процессов, исследования проводили на каждом станке в течение смены. Обрабатывали из заготовок, с одинаковыми параметрами и одинаковым остро заточенным инструментом. Измеряли не погрешность размера или отклонение формы, а объём остаточного слоя материала на обработанной поверхности. Показатель χ имеет пределы измерения

$$0 \leq \chi \leq \pm 1$$

При значении «ноль» ситуация предельная, когда погрешность отсутствует. При значении «единица», когда станок настолько плох, что не производит съём стружки. Если расстояние от 0 до 1 разделить на равные части, то получим шкалу и единицу измерения в виде безразмерной величины 0,1 КС (качества станка). Результаты экспериментов представлены на рис.3.

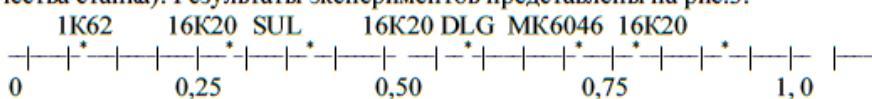


Рис. 3. Шкала качества станков токарной группы
Литература

1 Металлорежущие станки /Под ред. В.Э. Пуша, - м.; Машиностроение, 1986, - 575 с.

Выводы

1 Разработанный показатель даёт возможность оценивать свойства станков разного конструктивного исполнения и в любой момент эксплуатации.

2 Для получения сравнимых результатов оценки требуется воспроизводить условия рабочего процесса в одинаковых условиях.

3 Данный подход применим для станков универсального назначения, в том числе и для ЧПУ.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ КМОП СБИС БОРТОВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭСР

к.т.н., доцент Жаднов В.В.
МИЭМ НИУ ВШЭ, г. Москва

Рассмотрены основные этапы формирования модели интенсивности отказов КМОП СБИС из-за воздействия ЭСР. Показано, что для бортовой космической аппаратуры вероятность воздействия ЭСР может быть определена на основе характеристик окружающей радиационной обстановки.

STUDY OF THE METHOD OF MODELING FAILURE VHSIC/VHSIC-LIKE BOARD SPACE EQUIPMENT DUE TO THE IMPACT OF ESD

Zhadnov V.

The main stages of forming a model of the failure rate of VHSIC/VHSIC-LIKE due to the impact of ESD. It is shown, that for the on-board space equipment likelihood of exposure to ESD may be determined on the basis of the characteristics of radiation situation.

Исследование осуществлено в рамках «Программы фундаментальных исследований» НИУ ВШЭ в 2013 году. Отказы из-за катастрофических электрических перегрузок (EOS) представляют собой события, не связанные с внутренними механизмами отказов ИС, т.к. они являются результатом воздействия приложенного внешнего напряжения (или тока). Развитие отказов, связанных с

воздействием EOS или электростатического разряда (ESD), не зависит от степени интеграции и определяется реальным уровнем стойкости конкретной микросхемы (за счет соответствующих схемотехнических и технологических решений) и условиями ее применения (характеристиками окружающей электрической среды), зависящими только от изготовителя радиоэлектронной аппаратуры.

Поскольку эти отказы не связанны с внутренними механизмами отказов ИС, то они не зависят от времени, а зависят только от вероятности возникновения чрезмерного напряжения (V_{STRESS}) в окружающей электрической среде и чувствительности ИС к его воздействию. Следовательно, вероятность возникновения EOS может быть представлена как постоянная величина в функции распределения чувствительности ИС к воздействию V_{STRESS} .

Хотя существует много видов источников EOS, каждый со своими собственными характеристиками, наилучшим источником информации о чувствительности ИС (и в большинстве случаев единственным источником) являются испытания, предусмотренные в MIL-STD-883, метод 3015 [1]. Несмотря на то, что метод 3015 является лишь одним из методов измерения чувствительности ИС к воздействию EOS, но в силу его широкого распространения его результаты могут использоваться в математической модели интенсивности отказов из-за воздействия EOS (λ_{EOS}) при построении функции распределения чувствительности ИС к воздействию V_{STRESS} .

Обоснованием возможности использовании такого подхода является и то, что чувствительность ИС к воздействию EOS и уровень стойкости ИС к воздействию ESD сильно коррелированы.

Таким образом, в методе моделирования отказов из-за EOS, приведенном в RADS-TR-89-177 [2], отказы ИС рассматриваются только как результат катастрофических воздействий окружающей электрической среды.

Рассмотрим основные этапы формирования математической модели λ_{EOS} .

Исходя из выше изложенного, в основу модели λ_{EOS} положено следующее соотношение:

$$P(f) = P(c) \cdot P(f|c), \quad (1)$$

где: $P(f)$ - вероятность отказа ИС из-за воздействия EOS или ESD; $P(f|c)$ - вероятность отказа ИС из-за воздействия EOS или ESD при контакте с источником EOS или ESD; $P(c)$ - вероятность контакта ИС с источником EOS или ESD.

Для получения вероятности $P(f|c)$ были использованы данные, которые характеризуют распределение V_{STRESS} для всех классов микросхем. Это распределение можно аппроксимировать логнормальным распределением со средним значением, равным 2200 В [3]. Выборка, на основе которой это распределение было получено, и выборка, на основе которой средняя интенсивность отказов из-за воздействия EOS или ESD была рассчитана, должны быть очень похожи, так как они являются репрезентативными для обеспечения хорошего усреднения по типам, технологиям и окружающим электрическим средам.

В таблице 1 представлены моменты распределения, которые были получены в работе [4] в предположении нормального распределения V_{STRESS} как функции от стойкости к ESD (порогового напряжения - V_{TH}).

Таблица 1 - Моменты распределения V_{STRESS}

Моменты V_{STRESS}	$V_{STRESS} < V_{TH}$	$V_{STRESS} > V_{TH}$	Среднее
1	2	3	4
Мат. ожидание, В	1175	8000	4600
Ст. отклонение, В	375	1750	2000

Средние значения, приведенные в столбце 4 таблицы 1, являются параметрами распределения V_{STRESS} , для которого была получена средняя интенсивность отказов из-за воздействия EOS или ESD.

Можно предположить, что распределение V_{STRESS} не является нормальным распределением, каковое было использовано в [4], а, скорее, является логарифмически-нормальным [3] или экспоненциальным распределением. Экспоненциальное распределение интуитивно понятно и более

адекватно, поскольку вероятность возникновения напряжения $V_{STRESS} > V_{TH}$ в окружающей электрической среде возрастает при снижении стойкости ИС к воздействию ESD.

Предполагая, что распределение экспоненциальное, и используя среднее значение напряжения ($V_{STRESS} = 4500$ В), для показателя экспоненты $\left(\Theta = -\frac{\ln 0,5}{4500}\right)$ получается значение Θ равное 0,0002 и, соответственно, следующая функция плотности вероятности V_{STRESS} :

$$f(V_{STRESS}) = 0,0002 \cdot e^{-0,0002 \cdot V_{STRESS}}. \quad (2)$$

Подставив (2) в выражение (1) получают:

$$e^{-\lambda_{EOS} \cdot t} = 1 - P(V_{STRESS}) \cdot e^{-0,0002 \cdot V_{STRESS}}. \quad (3)$$

Разрешив (3) относительно λ_{EOS} для $t = 0,00876 \cdot 10^6$ получают:

$$\lambda_{EOS} \cdot 10^6 = \frac{-\ln [1 - P(V_{STRESS}) \cdot e^{-0,0002 \cdot V_{STRESS}}]}{0,00876} \quad (4)$$

Несмотря на тот очевидный факт, что окружающая электрическая среда, в которой функционирует ИС, является главным фактором отказов из-за воздействия EOS, ее характеристики не могут быть использована в модели λ_{EOS} , поскольку пользователи модели, как правило, не имеют достоверных данных об этих характеристиках, позволяющих оценить вероятность возникновения EOS.

Например, в авиационном электронном оборудовании наблюдается большое число отказов ИС из-за воздействия EOS, несмотря на то, что характеристики электропитания оборудования известны. Это лишний раз подтверждает то, что количественная оценка величины уровня воздействия EOS в зависимости от характеристик окружающей электрической среды является сложной задачей и в RADS-TR-89-177 [2] такая задача не рассматривалась. Поэтому при разработке модели λ_{EOS} для была получена только её зависимость от стойкости ИС к воздействию ESD вида (2).

Для оценки значения $P(V_{STRESS})$ в RADS-TR-89-177 [2] использовано значение среднего напряжения V_{STRESS} равное 2200 В и значение средней интенсивности отказов равное $0,0419 \cdot 10^{-6}$, полученные по данным RAC [3, 5]. В этом случае значение $P(V_{STRESS})$ для $t = 0,00876 \cdot 10^6$ составит:

$$P(V_{STRESS}) = \frac{1 - e^{-0,0419 \cdot 10^{-6} \cdot 0,00876 \cdot 10^6}}{\int_0^{2200} 0,0002 \cdot e^{-0,0002 \cdot V_{STRESS}} dV_{STRESS}} = \frac{0,000367}{0,644} = 0,00057.$$

Подставив это значение в (4) и приравнивая $V_{STRESS} = V_{TH}$ получают итоговую математическую модель λ_{EOS} :

$$\lambda_{EOS} \cdot 10^6 = \frac{-\ln [1 - 0,00057 \cdot e^{-0,0002 \cdot V_{TH}}]}{0,00876}. \quad (5)$$

Несмотря на то, что модель (5) получена на основе статистических данных по чувствительности ИС к воздействию V_{STRESS} , полученных в 80-х годах прошлого века, она применяется до настоящего времени. Например, модель (5) входит в математические модели интенсивностей отказов КМОП СБИС, рекомендованные в американских справочниках по прогнозирования надежности MIL-HDBK-217 [6] и RIAC-HDBK-217Plus [7], для учета влияния отказов из-за воздействия EOS или ESD.

Однако, в ряде случаев значение $P(V_{STRESS})$ можно оценить исходя из особенностей механизма возникновения ESD. Например, у ИС в пластиковых корпусах, применяемых в бортовой космической аппаратуре, ESD может возникнуть не только в результате прямого воздействия окружающей электрической среды, но и результате накопления заряда в материале корпуса ИС из-за воздействия ионизирующего излучения космического пространства. В этом случае значение $P(V_{STRESS})$ в модели (4) при таком механизме возникновения ESD можно найти на основе тех же характеристик окружающей радиационной обстановки на орбите космического аппарата, которые используются при расчетах радиационной стойкости ИС.

Литература

1. MIL-STD-883.
2. RADS-TR-89-177. VHSIC/VHSIC-LIKE reliability prediction modeling. - RADS, 1989.

3. VZAP-1. Electrostatic discharge susceptibility of electronic device/ - Reliability analysis center publication, 1983.
4. Giusti, J. The probability of an ESD failure in unprotected equipment. / J. Giusti. // Electrical overstress/Electrostatic discharge symposium proceedings, 1986.
5. MDR-21. Microcircuit device reliability trend analysis. - Reliability analysis center publication, 1985.
6. MIL-HDBK-217F. Reliability prediction of electronic equipment. - USA: DoD, 1995.
7. RIAC-HDBK-217Plus. Hand book of 217PlusTM reliability prediction models. - USA: DoD, 2006.

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО СЧЁТЧИКА

Ковтсова И.О., к.ф-м.н Ухов В.И.
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
Филиал «Протвино»

В данной статье рассматривается архитектура программного обеспечения «MeterSoft», предназначенного для счётчика электроэнергии.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE SOFTWARE FOR DIGITAL METER

Kovtsova I., PhD Ukhov V.

This article describes the software architecture «MeterSoft», intended for the electricity meter.

Сегодня развитие современных аппаратных и программных средств позволяет осуществить революционный переход в новый век – век цифровой подстанции. Основная идея «цифровой» подстанции состоит в создании систем контроля, защиты и управления нового поколения, где вся информация переводится в цифровой формат на уровне интеллектуального первичного измерительного оборудования и далее передается уже в таком виде вторичному интеллектуальному микропроцессорному оборудованию. К первичному измерительному оборудованию относятся высоковольтные цифровые измерительные оптические трансформаторы тока и напряжения, интеллектуальные выключатели, а к вторичному – микропроцессорные устройства РЗ и автоматики, многофункциональные приборы измерений и учета. Устройства работают на едином стандартном протоколе обмена информацией — IEC 61850 (МЭК 61850).

МЭК 61850 является объектно-ориентированным протоколом, сфокусированным на автоматизацию подстанций, и значительно расширяющим возможности предшествующих стандартов. Область применения стандарта МЭК 61850 – системы связи внутри подстанции. Это набор стандартов, в который входят стандарт по одноранговой связи и связи клиент-сервер, стандарт по структуре и конфигурации подстанции, стандарт по методике испытаний, стандарт экологических требований, стандарт проекта.

Оптические трансформаторы осуществляют измерение мгновенных значений тока и напряжения, их оцифровку и высокоскоростную передачу данных по оптическим каналам связи, по так называемой шине процесса (Process Bus). Передача данных осуществляется по протоколу МЭК 61850-9-2. Измеренные мгновенные значения получают различные интеллектуальные электронные устройства. Одним из таких устройств является счётчик электрической энергии.

Компания ООО "Систел" разрабатывает линейку устройств "SysteLLLogic" для цифровой подстанции на современной программно-аппаратной базе. Особое внимание уделяется разработке архитектуры программного обеспечения для интеллектуальных устройств (IED-счётчик, мультиметр и анализатор показателей качества электроэнергии).

На рисунке 1 приведена архитектура программного обеспечения «MeterSoft». Процесс xWriter (Писатель) принимает мгновенные значения тока и напряжения по трём фазам и нетрали в соответствии с МЭК 61850-9-2 LE по сетевому интерфейсу и записывает их с отметкой времени в разделяемую память (Shared memory). Процесс MeterSoft считывает данные из разделяемой памяти и производит расчёты. Частота дискретизации данных согласно МЭК 61850-92-LE может быть 80 или 256 выборок на период с частотой сети 50 Гц (4000 или 12 800 срезов мгновенных значений в секунду). Как правило, производители устройств делают поддержку двух этих режимов, хотя для учёта электроэнергии частота дискретизации передаваемых данных должна быть не хуже 256 точек на период.

Счётчик, используя мгновенные значения тока и напряжения, рассчитывает секундный профиль, состоящий из: